



TAKADA

出展のご案内

<超音波カッティング装置(量産用途)>

SiC, Ga₂O₃やセラミックス基板を超音波アシスト切断で
高速・高品質でダイシング
最新鋭フルオート機『CSX501』

実機展示



<超音波カッティング装置(不良解析/品質確認用途)>

不良箇所の解析及び工程内の品質管理や、
研究開発の観察用途など、幅広い分野で使用され続ける
断面観察用カッティング装置『CSX-100Lab』

実機展示

<枚葉式ウェット処理装置>

有機膜剥離・洗浄・リフトオフと1台でフレキシブルに対応
枚葉式ウェット装置『TWP』シリーズ

※バッチ洗浄機、IPA洗浄乾燥機などもラインナップしております

パネル展示



電子機器・半導体の設計開発、生産の
トレンドがわかる

第2回

ネプコン ジャパン 秋

エレクトロニクス開発・実装展

電子部品・
材料

プリント
配線板

製造・
検査装置

パワー
デバイス
技術

etc...

会期 2023.9.13 (水) - 15 (金) 10:00 - 17:00

会場 幕張メッセ

会期： 2023年9月13日（水）～ 15日（金） 10:00～17:00
会場： 幕張メッセ
出展場所： 6-1



詳しくは、ホームページから



株式会社 高田工業所
装置事業部
北九州市八幡西区築地町2-1

WEB: <https://www.takada.co.jp/>

超音波カッティング装置 高田

